



プリント基板取付寸法
(コネクタ搭載面)
PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING
HOLE DIMENSIONS
(CONNECTOR MATING SURFACE)

注記

- 材料: コネクタ... 黄銅
ハウジング... 熱可塑性ポリエステル樹脂 (灰色)
- 表面仕上げ (コネクタ)

下地メッキ	ニッケル
予田メッキ部	予田メッキ
コネクタ寄接部	金メッキ (0.2μm) 予田メッキ
その他	封孔処理

NOTES

- MATERIAL; CONTACT HOUSING: BRASS
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN. (GRAY)
- FINISH; UNDER PLATE TYNE AREA: NICKEL
CONTACT AREA: TIN-LEAD
(POROSITY SEALED): GOLD (0.2μm)

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C 105 (J100-0098-93) TY ISM
B 128 (J-12880) TY ISM
A 132 (J-10394) TY ISM
D 9E BY 2/27/87
LTR SEE REVISION RECORDS DR. CHK. DATE

174254-1	32	54.1	47.3	38.1	44.6	4.12
3.00	115.1	110.3	99.06	105.5		
-2.64	94.8	90	78.74	85.3	6.13	20.27
顧客型名 型番 (mm) 規格 A B C D コーディング位置 (CORDING)						
C 105 100-0098-93 BY AMP (Japan) LTD. AMP TOKYO, JAPAN						
WIRE RANGE	INSULATION DIA	SERIAL				
DR-DIN コネクタ X-IL 予田付 9AT						
SIZE	LOC	SERIAL NO.				
C	J	C-174254				
SCALE	REV.	SHEET				
	C	1 OF 1				